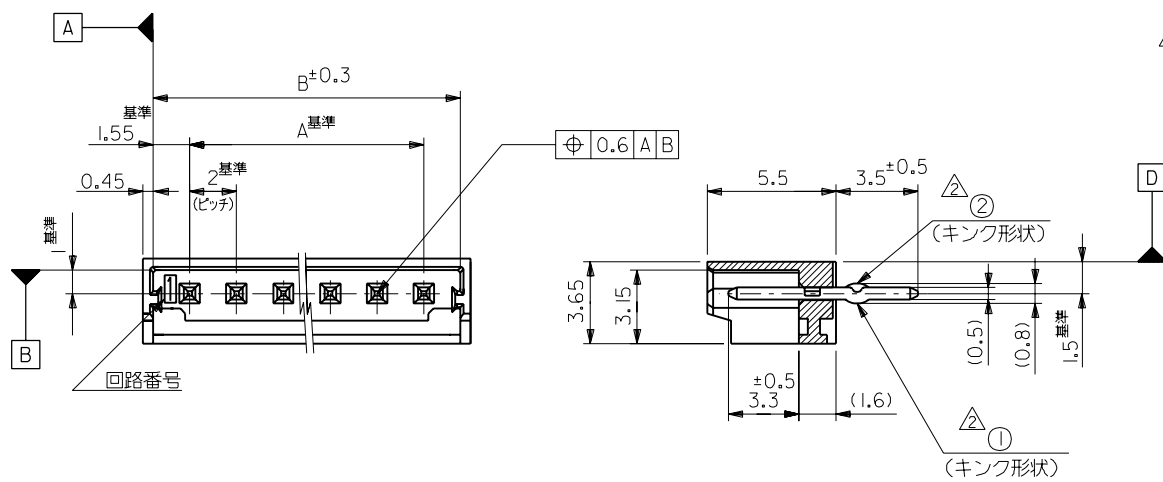
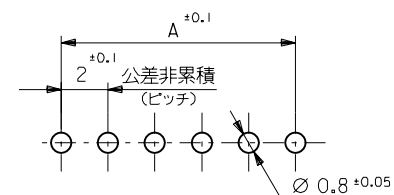




注 記

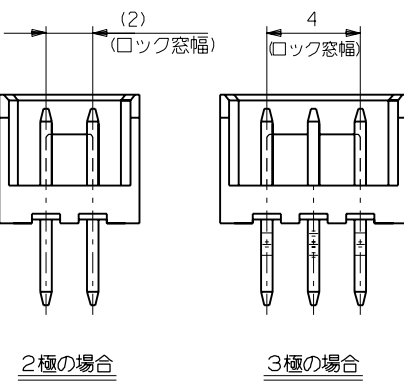
- 1 嵌合相手: 51065-***00
 2 キンフは下記表の位置及び形状に付加のこと。 2極はキンフ無し。

回路番号	1	2	3	4	5	N-2	N-1	N
極数	1	2	3	4	5	6	7	8
6 極以上	—	①	②	—	—	②	①	—
5 極	①	②	—	②	①	—	—	—
4 極	①	②	②	①	—	—	—	—
3 極	①	②	①	—	—	—	—	—



基板取付穴寸法 (参考)
 (t = 1.6)

32	31.1	28	53253-1510	15
30	29.1	26	-1410	14
28	27.1	24	-1310	13
26	25.1	22	-1210	12
24	23.1	20	-1110	11
22	21.1	18	-1010	10
20	19.1	16	-0910	9
18	17.1	14	-0810	8
16	15.1	12	-0710	7
14	13.1	10	-0610	6
12	11.1	8	-0510	5
10	9.1	6	-0410	4
8	7.1	4	-0310	3
6	5.1	2	53253-0210	2
C	B	A	ENG NO.	極数

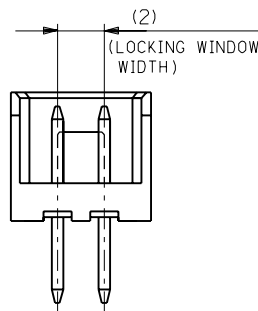
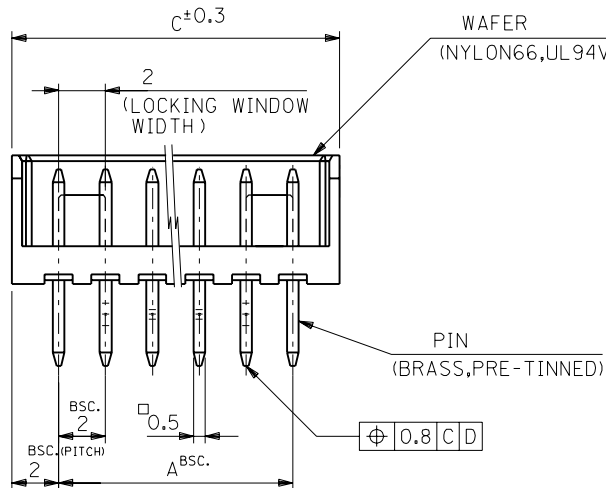
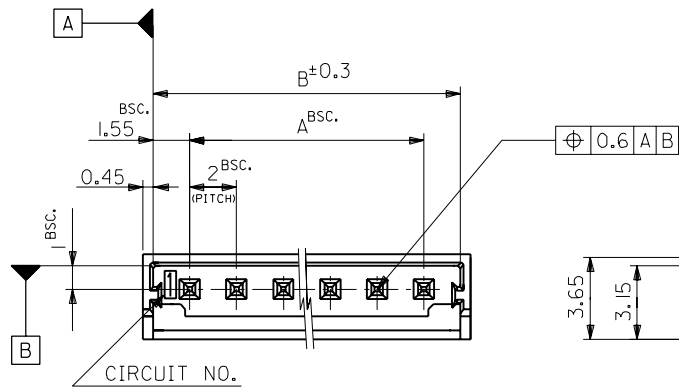


材料 MATERIAL	図中参照	moLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	図中参照	EDP. NO.
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO.
被覆外径 INS. RANGE	—	SD-53253-***10
DRAWN BY 9/2/91 S. AIHARA	CHK'D BY 9/2/91 M. KUKUSHIMA	REV C
APPRO'D BY 9/2/91 W. KANOMOTO	DATE 9/2/91	TITLE 名称
REVISION RECORD	REVISION RECORD	NEW 2.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y (ST.)
角度 ANGLE	±3°	SCALE 5-1
30 以上 OVER	±0.3	
10 以上 30 未満 UNDER	±0.25	
10 未満 UNDER	±0.2	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISION RECORD	

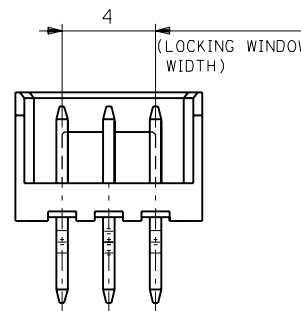
ENG. NO.
SD-53253-**-10

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



IN CASE OF
2 CIRCUIT WAFER

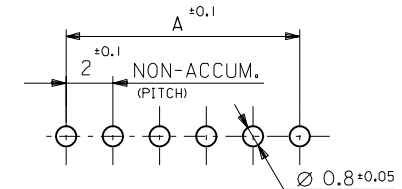


IN CASE OF
3 CIRCUIT WAFER

NOTES

1. MATES WITH: 51065-**-00
2. KINK TO BE APPLIED AS FOLLOWS, 2 CIRCUIT HAS NO KINK

CKT NO.	1	2	3	4	5	N-2	N-1	N
6 CKT	—	①	②	—	—	②	①	—
5 CKT	①	②	—	②	①	—	—	—
4 CKT	①	②	②	①	—	—	—	—
3 CKT	①	②	①	—	—	—	—	—



RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE
DIMENSION (REFERENCE)
(t = 1.6)

32	31.1	28	53253-1510	15
30	29.1	26	-1410	14
28	27.1	24	-1310	13
26	25.1	22	-1210	12
24	23.1	20	-1110	11
22	21.1	18	-1010	10
20	19.1	16	-0910	9
18	17.1	14	-0810	8
16	15.1	12	-0710	7
14	13.1	10	-0610	6
12	11.1	8	-0510	5
10	9.1	6	-0410	4
8	7.1	4	-0310	3
6	5.1	2	53253-0210	2
C	B	A	ENG NO.	CKT

角度	ANGLE	°
30 以上	OVER	+3°
10 以上 30 未満	OVER	+0.3
10 未満	UNDER	+0.25
10 未満	UNDER	+0.2
一般公差	GENERAL TOLERANCES	

	C	REVISED (J20439)	T.T. M.S. '92/12
	B	REVISED (J10095)	T.T. S.I. '91/02
	A	REVISED (J00016)	T.T. S.I. '90/12
05	O	PROPOSED (J91084)	T.T. S.I. '89/12
	記号	変更内容	DR. 日付
	LTR	REVISION RECORD	CHK. DATE

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料	REFER TO DRAWING
仕上げ	REFER TO DRAWING
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY: 89/9/21	CHK'D BY: 89/9/21
S. AIHARA	M. FURUSHIMA
APP'D BY: 89/9/21	SCALE 5-1
M. ENOMOTO	

moLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP NO.	
ENG. NO. SD-53253-**-10	
REV C	
TITLE 名称 NEW 2.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y (ST.)	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8